

合肥颀中科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-025

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演/反路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参加 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
来访单位名称	Khazanah Nasional Bhd (P), Malaysia、Matthews International Capital Mgmt LLC (P), USA、Newton Investment Management (P), UK、Polunin Capital Partners Ltd (P), UK、Shanghai Mega Trust Investment Co Ltd (P), CN、UG Investment (P), Singapore、UBS Securities 等
时间	2024年9月4日
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书、财务总监：余成强 证券事务代表：陈颖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 问：公司 AMOLED 的营收占比？ 答：受惠于 AMOLED 在手机及平板应用的渗透率持续增加、显示面板产业向中国大陆转移以及国内显示芯片供应链已趋于完善等因素，AMOLED 营收占比呈逐步上升趋势，2024 年第二季度 AMOLED 营收占比约 25%。</p> <p>2. 问：公司显示业务的主要工艺流程？ 答：主要可分为前段的金凸块制造（Gold Bumping）、晶圆测试（CP）以及后段的玻璃覆晶封装（COG）、薄膜覆晶封装（COF）等制程。</p> <p>3. 问：公司高端测试机的扩产计划？主要从哪里进机？ 答：目前公司的高阶测试机仍在持续进机中；进机台的速度和数量则会根据目前订单的掌握情况并兼顾设备供应商的交期和出货数量限制等因素，综合考虑后弹性调整。公司目前主要从爱德万进机。</p> <p>4. 问：合肥厂厂房折旧年限和机器设备折旧年限是多久？折旧增加多少？ 答：合肥厂厂房折旧年限是 20 年，机器设备折旧年限是 5-10</p>

	<p>年。2024 年折旧增加约 5,000 万元。</p> <p>5. 问：公司发展非显示类芯片封测业务的优势？</p> <p>答：依托在显示驱动芯片封测领域多年来的耕耘以及对凸块制造技术的积累，公司于 2015 年将业务拓展至非显示类芯片封测市场，目前该领域已日渐成为公司业务重要的组成部分以及未来重点发展的板块。公司现可为客户提供包括铜柱凸块（Cu Pillar）、铜镍金凸块（CuNiAu Bumping）、锡凸块（Sn Bumping）在内的多种高端金属凸块制造，同时大力发展基于砷化镓、氮化镓、钽酸锂等第二代、第三代半导体材料的凸块制造与封测业务，持续加强后段 DPS 封装业务的建设，提升全制程封测能力。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 9 月 5 日